

サーモスター/低硬度タイプ

Thermostar/Low hardness

TMS-US18 series



特長

Features

- ▶ 低硬度により、幅広いクリアランスに対応し、基板への負担を軽減します。
 - ▶ シロキサン含有量を低減。
 - ▶ 熱源の形状に合わせてカット納品が可能です。
- The low hardness, and a wide range of clearance, to reduce the burden on the substrate.
Low siloxane content.
The sheet can be cut to the shape of the heat source before shipment.



E322053

用途

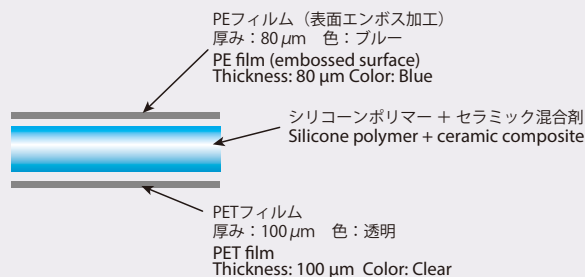
Applications

- ▶ CPU、ICの放熱対策。
- ▶ パワー IC の熱対策。
- ▶ スイッチング電源の熱対策。
- ▶ その他、さまざまな熱源に対応します。

Heat dissipation of CPU and IC.
Heat management of power IC.
Heat management for switching power supply.
Various other heat sources.

構造

Structure



品番表

Product list

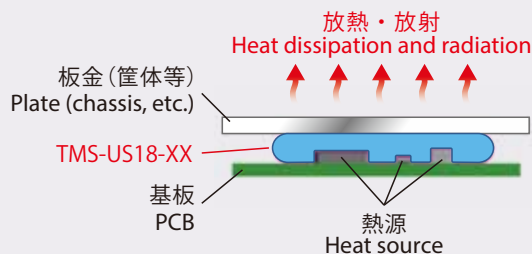
[単位 Unit:mm]

品番 Product code	厚み Thickness	定尺 Fixed sizes	
		幅 Width	長さ Length
TMS-US-18-10	1.0±0.2	300 +5/-0	300 +5/-0
TMS-US-18-15	1.5±0.2	300 +5/-0	300 +5/-0
TMS-US-18-20	2.0±0.3	300 +5/-0	300 +5/-0
TMS-US-18-30	3.0±0.3	300 +5/-0	300 +5/-0
TMS-US-18-40	4.0±0.3	300 +5/-0	300 +5/-0
TMS-US-18-50	5.0±0.4	300 +5/-0	300 +5/-0
TMS-US-18-60	6.0±0.5	300 +5/-0	300 +5/-0

※製品厚み寸法は PE・PET フィルムを除いた寸法値です。
* Product thickness excludes PE and PET films.

使用例

Application examples



一般特性

General characteristics

項目 Item	TMS-US18
外観色 Appearance (color)	ライトブルー Light blue
密度 (g/cm ³) Density (g/cm ³)	2.7
熱伝導率 (W/m・k) * Thermal conductivity (W/m・k)*	1.8
硬度 (アスカーC) Hardness (Asker C)	9
体積抵抗率 (Ω・cm) Volume resistivity (Ω-cm)	10 ¹²
引張強度 (MPa) Tensile strength (MPa)	0.08
使用温度範囲 (°C) Operating temperature range (°C)	-40~160 -40 to 160

※京都電子工業株式会社 QTM-500 迅速熱伝導率計による測定値。
* Measurement with Kyoto Electronics Manufacturing's QTM-500 quick thermal conductivity meter.